

2005年2月2日

中国に半導体用封止材の生産拠点を新設

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：153億円)は、ロジック向けを中心とした半導体用封止材の生産を中国・江蘇省蘇州市にて開始し、中国市場における半導体材料の事業基盤を強化する方針です。蘇州工業園區に「日立化成工業(蘇州)有限公司」を新たに設立、約25億円を投じて年間生産能力6,000トンの新工場を建設する予定です。

中国では半導体産業が急速に立ち上がりつつあり、従来は日本、台湾を中心とした後工程の工場が多く進出していましたが、近年、日本、欧米、台湾、韓国などの有力半導体メーカーが前・後一貫工程の大規模工場を相次いで建設するとともに、中国国内においても各企業が半導体生産に乗りだしており、今後一段と大きな成長が見込まれます。こうした流れの中で、中国市場において積極的な売上拡大を進めていくためには、現地に生産拠点を構え、納期、技術サービス等の面で顧客のきめ細かな要求に着実に応えていくことが不可欠と判断し、現地生産拠点を確立することにしたものです。

当社は、現在下館事業所(南結城)(茨城県結城市)およびマレーシア日立化成(ペナン州)にて半導体用封止材を生産しており、今般中国で生産拠点を新設することにより、年間約3万トンの供給体制が整います。2010年には中国における市場占有率を現在の約20%(当社推定)から40%以上にまで高め、トップシェアを獲得する計画です。今後、本拠点を足掛かりに電子材料の中国事業の拡大を加速してまいります。

<新会社及び工場の概要>

会社名	： 日立化成工業(蘇州)有限公司
設立場所	： 中国江蘇省蘇州市蘇州工業園區内
資本金	： 1,000万 US\$ (約10億円)
出資者	： 日立化成工業株式会社(100%)
総投資額	： 約2,500万 US\$ (約25億円)
着工時期	： 2005年4月(年内稼動予定)
土地面積	： 約66,000㎡
生産能力	： 約6,000トン(年ベース)

以 上

(報道関係お問い合わせ)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室 広報担当 野口 TEL 03-5381-2377